

[별표 제2호]

용 도 설 명 서

구매의뢰번호 : _____

품 명	(국문) OLEDoS 패널 구동용 FPCB 기판 모듈 구매
	(영문) Purchase of Flexible Printed Circuit Boards (FPCB) for OLEDoS panel driving
규 격	EA
과 제 명	XR전방산업 선도형 핵심 광학 부품모듈 시험제작 서비스 지원
사용용도	OLEDoS 기반의 마이크로 디스플레이 구동을 위한 필수 부품 소자임
1. 본 구매 물품은 산업혁신기반구축사업(과제명 : XR전방산업 선도형 핵심 광학 부품모듈 시험제작 서비스 지원)을 원활히 수행하기 위해 구매하고자 함 2. 본 물품은 기술원에서 보유하고 있는 OLED 증착 시스템을 이용해 제작한 마이크로 디스플레이 패널을 구동시키기 위한 필수적인 부품으로서, 본 구매 물품 상에 공정을 통해 제작된 OLEDoS 패널을 Package 공정(COB, chip on board 및 wire bonding)을 통해 최종 완성된 OLEDoS Module 소자는 다양한 XR 영상표시 모듈로 활용됨. 3. 본 물품은 XR 영상표시 모듈 시험제작 공정지원에 활용되는 부품으로, 마이크로 디스플레이 공정을 통해 제작된 패널의 구동을 위한 유연회로 기판임. 이를 통해 실제 XR 디바이스에 적용되는 영상표시 소자인 마이크로 디스플레이를 구동하여 시험제작 공정지원에 활용할 예정임 4. XR 디바이스용 마이크로 디스플레이 증착 소자의 최종적인 신뢰성 및 구동을 위한 부품으로서, OLEDoS 유기증착 공정 후 Package공정에서 사용되는 최소한의 필수 부품 소자로 본 물품의 구매가 필요함	

상 세 규 격 서

구분	품명	단위	수량	비고
1	FPCB(Flexible Printed Circuit Boards)	EA	1,000	
상 세 내 역				
<u>1. 구성</u> 1. OLEDoS 구동용 Flexible Printed Circuit Boards (FPCB)				
<u>2. 성능 및 규격</u> Purchase of Flexible Printed Circuit Boards (FPCB) for OLEDoS Driving - OLEDoS Backplane IC 구동용 유연 회로 - 0.55 " active display diagonal 패널 구동용 FPCB (패널 COB(chip on board) 공정용 부착 위치 형성) - Full-HD (1920x1080) 해상도용 FPCB - Wire bonding용 scan 전극 및 data 전극 pad 형성 - MIPI D-PHY/DSI video interface - DAC output voltage - Low power: 100 mW @90 Hz Frame rate				
<u>3. 기타사항</u> 가. 설치위치 : 경북 구미시 구미대로 350-27 구미전자정보기술원 나. 납품기한 : 계약 후 5주(35일) 이내 다. 무상보증기간 : 납품 및 검수 후 1년 라. 규격 관련 문의사항 : 배형우 선임 054-460-9083				